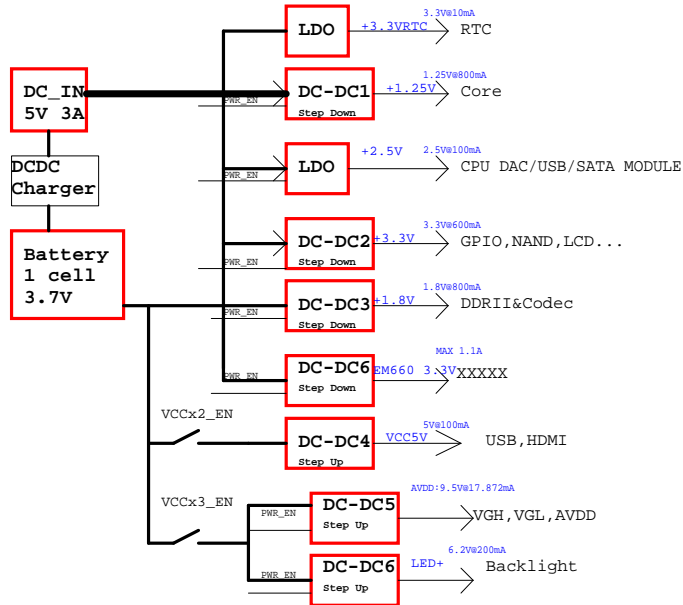


POWER



1. DDRII can be used 2 PCS 64Mx16bit, 2 PCS 128Mx16bit, 4 PCS 128Mx8bit, 8 PCS 256Mx4bit. Recommend 2 PCS 64Mx16bit.
2. Many NAND types are available (TSOP-48 or LGA52 package). You can use two NANDs (4 CE total) and 1 PCS I-NAND (SDIO interface). This board only reserved for TSOP, if you need, you can add other type package.
3. USB 2.0. USB_A is a OTG type. USB_B is USB_Host only.

UPGRADE LIST:

V1R1:

1. PAGE4 增加 LGA flash (U41) 与 INAND (U42)
2. PAGE4 FLASH WP 增加阻容滤波 (R321/C402)。
3. PAGE2 1.2V 调压恒流源网络滤波电容 C404 由 0.1uF 改成 10nF。

V1R2:

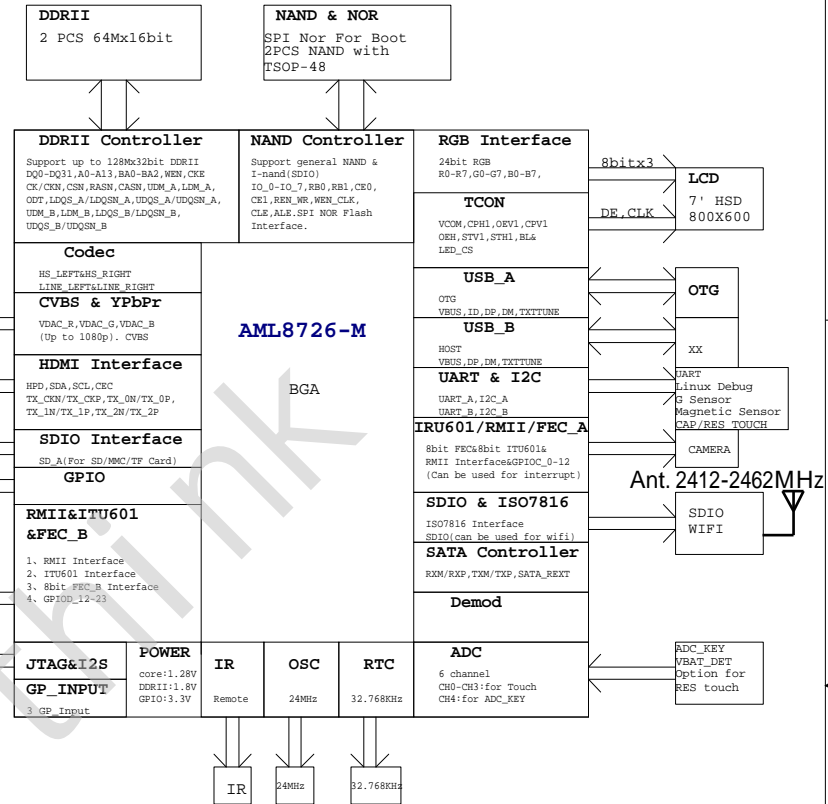
1. PAGE4 NAND U22 38PIN (地) 与 3.3V 网络短接修正。

V1R3:

1. PAGE4 删除 DDR 3 个 test pin 和 PZQ 地连接; nand 电阻配置说明更正。
2. PAGE6 修改耳机插入侦测 HP_IN 连接方式, 满足插入“耳麦型插头”时能正常侦测。
3. PAGE3 内置 RES Touch ADC 通道改留测试点 (TP39-TP42), 方便 layout。
4. PAGE9 NC WIFI/BT Module 有源晶振 Y3, 默认使用 8726M 内部 STH pin 产生 32.768K. 增加 32.768K 网络分压电阻 layout 说明。
5. PAGE2 D3 注明使用 DDZ9689; NC R96。

V1R4:

1. PAGE3 RTC 取消 1K 串阻 (OSCIN/OUT); C236 由 33pF 改成 27pF; R301 由 NC 改成 22R; 电池电压侦测取电从 VCCX2 改到 VBAT. ADD "U20 本体下方增加散热 PAD" 说明。
2. PAGE5 C304 由 10nF 改成 0.1uF. U25 改用 MP3202。
3. PAGE10 增加备选摄像头广州大凌实业有限公司 DC-100628A/200W pixels 说明; upgrade 友立森摄像头型号为 MC-03G04A。
4. PAGE2 增加 R180, 预防电池误进入保护, 增加 D22, 防止在系统没供电前, DC_IN 电压通过 DC_DET 漏到 VCC3.3V; R216 改为 1.2K 1%; 开机检测电路修改。
5. 主要器件属性中增加联系方式。
6. HDMI 接电视时, 为预防电压漏到 MID 上: PAGE3 将 CPU wifi Module 3.3V 取电由 HDMI_3.3V 改到 ADC_3.3VA. NC FB28, Cancel C216; HDMI_3.3V 从 LDO U9 取电. PAGE8 增加 D24。
7. PAGE9 预留 FM 电路。



File		AML8726-M_MID_Ref_B_3G	
Size	Custom	Document Number	Rev
Block		V1.4	
Date:	Wednesday, January 05, 2011	Sheet	1 of 10